

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示  
公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。敬请投资者注意投资风险,审慎作出投资决策。

1.3 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

## 第二节 公司基本情况

## 公司股票情况

| 股票种类 | 股票上市交易所    | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|------------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所科创板 | 芯源微  | 688037 | /       |

公司存托凭证情况

□适用 √不适用

联系人及联系方式

| 联系人及联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表)     | 证券事务代表              |
|----------|---------------------|---------------------|
| 姓名       | 李凤莉                 | 林丽霞                 |
| 电话       | 021-22692929        | 021-22692929        |
| 办公地址     | 辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号     | 辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号     |
| 电子邮箱     | 688037@kingsemi.com | 688037@kingsemi.com |

## 2.2 主要财务数据

| 单位:元 币种:人民币            |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产                    | 1,610,772,321.83 | 1,224,590,620.97 | 31.53           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 830,361,935.34   | 798,597,049.69   | 3.98            |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 营业收入                   | 390,098,038.29   | 62,466,822.85    | 461.85          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 35,069,938.76    | 6,217,516.28     | 464.05          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,577,100.81    | -14,387,930.94   |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -139,178,539.95  | -55,579,693.34   |                 |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 4.30             | 0.02             | 增加3.28个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.42             | 0.07             | 500.00          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.42             | 0.07             | 500.00          |
| 研发投入占营业收入的比例(%)        | 14.08            | 22.78            | 减少8.70个百分点      |

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 截止报告期末股东总数(户)           | 6,822 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 0     |
| 截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0     |

| 前10名股东持股情况                              |         |             |            |                                                                                           |                   |                   |
|-----------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例<br>(%) | 持股<br>数量   | 持有有限售<br>条件的股份数量                                                                          | 包含融资融券<br>出借的股份数量 | 质押、标记或冻<br>结的股份数量 |
| 沈阳先进制造技术产业有限公司                          | 境内非国有法人 | 17.06       | 14,332,430 | 14,332,430                                                                                | 14,332,430        | 无                 |
| 中国科学院沈阳自动化研究所                           | 国有法人    | 12.5        | 10,500,000 | 10,500,000                                                                                | 10,500,000        | 无                 |
| 辽宁科发实业有限公司                              | 国有法人    | 11.82       | 9,932,820  | 9,932,820                                                                                 | 9,932,820         | 无                 |
| 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司                     | 国有法人    | 6.09        | 5,115,000  | 0                                                                                         | 0                 | 无                 |
| 国瑞达                                     | 境内自然人   | 3.83        | 3,214,750  | 0                                                                                         | 0                 | 无                 |
| 京润隆                                     | 境内自然人   | 3.18        | 2,650,000  | 2,650,000                                                                                 | 2,650,000         | 无                 |
| 国科瑞德物联网创业投资有限公司                         | 境内非国有法人 | 2.68        | 2,280,000  | 0                                                                                         | 0                 | 无                 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-中国建设基金莱比什个月封闭运作混合型证券投资基金 | 其他      | 1.68        | 1,407,558  | 0                                                                                         | 0                 | 无                 |
| 李凤莉                                     | 境内自然人   | 1.67        | 1,400,000  | 1,400,000                                                                                 | 1,400,000         | 无                 |
| 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金         | 其他      | 1.31        | 1,102,156  | 0                                                                                         | 0                 | 无                 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |         |             |            | 上述股东中，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司与国科瑞德物联网创业投资有限公司存在关联关系，但不存在一致行动关系。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |                   |                   |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                     |         |             |            | 不适用                                                                                       |                   |                   |

## 2.4 前十名境内无托管凭证持有情况表

□适用 √不适用

## 2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

## 2.7 控股股或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

## 沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况  
经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2335号)同意注册,沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)21,000,000股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币26.97元,应募集资金总额为566,370,000.00元,根据有关规定扣除发行费用60,625,896.22元后,实际募集资金净额为505,744,103.78元,已于上述募集资金已于2019年12月10日到齐,募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告(辽验字[2019]8294号《验资报告》)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况  
2021年上半年度,公司募集资金使用情况为:(1)对募集资金专户投入76,152,623.61元,其中:高端晶圆产业化项目44,805,290.37元,高端晶圆研发中心项目31,347,324.24元;(2)使用超募资金永久补充流动资金38,300,000.00元;2021年上半年度公司累计使用募集资金114,452,623.61元,归还超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元,用暂时闲置募集资金购买理财产品60,000,000.00元,支付银行手续费(不含增值税)3,728.52元,募集资金专用账户利息收入为1,184,387.86元,使用暂时闲置募集资金购买理财产品所得投资收益386,130.14元,募集资金专用账户2021年6月30日余额合计为213,789,464.55元。具体明细如下:

| 项目                              | 金额             |
|---------------------------------|----------------|
| 募集资金净额                          | 505,744,103.78 |
| 减:截至2021年6月30日直接对募集资金项目投入       | 184,019,302.26 |
| 其中:高端晶圆处理产业化项目                  | 90,529,897.93  |
| 高端晶圆研发中心项目                      | 92,489,405.16  |
| 减:截至2021年6月30日使用募集资金永久补充流动资金    | 38,300,000.00  |
| 减:截至2021年6月30日用于暂时闲置的暂时闲置募集资金   | 50,000,000.00  |
| 加:截至2021年6月30日募集资金专项利息          | 1,184,387.86   |
| 加:截至2021年6月30日募集资金专户利息收入扣除手续费净额 | 7,466,294.65   |
| 募集资金余额                          | 213,789,464.55 |

## 二、募集资金管理情况

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,于2019年4月24日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2019年12月11日,公司分别与中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳城阳支行、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行和保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。公司于2019年12月11日在中信银行沈阳和平安支行开设募集资金专项账户(账号:811290112800643057),于2019年12月11日在招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行开设募集资金专项账户(账号:120404600110111)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。截至2021年6月30日,公司均严格按照按《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2021年6月30日,募集资金专项账户余额情况如下:

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,遵循公开、安全、高效、透明的原则,于2019年4月24日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2019年12月1日,公司分别与中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

## (一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

## (二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司使用自筹资金对“高端晶圆处理产业化项目”募集资金项目累计投入14,034,042.00元,对“高端晶圆处理产业化”募集资金项目累计投入3,389,400.00元,使用自筹资金支付发行费用人民币2,597,169.81元。

2020年4月24日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金14,034,042.00元,置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入自筹资金的情况,已获容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告[202011020064号《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司以自筹资金置换募集资金投资项目的鉴证报告》]。

截至2021年6月30日,上述自筹资金21,020,611.81元已用募集资金置换完毕。

## (三)对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月25日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过46,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过12个月内,在不违反上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

2020年12月24日,公司召开第二届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过30,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过12个月内,在不违反上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000万元,具体情况列示如下:

计投入14,034,042.00元,对“高端晶圆处理设备产业化”募集资金项目累计投入389,00元,使用自筹资金支付发行费用人民币2,597,169.81元。

2020年4月24日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金20,611.81元置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

## (一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

## (二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司使用自筹资金对“高端晶圆处理产业化项目”募集资金项目累计投入14,034,042.00元,对“高端晶圆处理产业化”募集资金项目累计投入3,389,400.00元,使用自筹资金支付发行费用人民币2,597,169.81元。

2020年4月24日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金14,034,042.00元,置换预先投入自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入自筹资金的情况,已获容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告[202011020064号《关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司以自筹资金置换募集资金投资项目的鉴证报告》]。

截至2021年6月30日,上述自筹资金21,020,611.81元已用募集资金置换完毕。

## (三)对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月25日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过46,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过12个月内,在不违反上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。

截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000万元,具体情况列示如下:

| 单位:人民币元      |                     |                |
|--------------|---------------------|----------------|
| 银行名称         | 银行账号                | 余额             |
| 中信银行沈阳浑南支行   | 811290112800643057  | 122,620.38     |
| 中国建设银行沈阳城阳支行 | 2105013000000001256 | 159,655,754.13 |
| 招商银行沈阳浑南西路支行 | 120404600110111     | 54,011,090.04  |
| 合计           |                     | 213,789,464.55 |

公司代码:688037

公司简称:芯源微

# 沈阳芯源微电子设备股份有限公司2021年半年度报告摘要

| 银行         | 产品名称   | 类型    | 金额       | 购买日       | 到期日      | 年化收益率 | 是否赎回 |
|------------|--------|-------|----------|-----------|----------|-------|------|
| 中信银行沈阳浑南支行 | 具赛信直付通 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021-5-10 | 2021-8-9 | 3.05% | 否    |
| 其他银行理财产品   | 具赛信直付通 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021-5-10 | 2021-8-9 | 3.05% | 否    |

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830.00万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在主营业务相关的生产经营中使用;在本次超募资金总额12,795.44万元内,不超过高风险投资或对外提供财务资助。公司超募资金总额为12,795.44万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为3,830.00万元,占超募资金总额的比例为29.93%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司于2021年6月11日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,使用部分超募资金计人民币3,830.00万元用于永久补充流动资金。截至2021年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(六)募集资金使用的其他情况  
公司于2020年7月2日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过1,000,000,000元用于暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月,以满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。

截至2021年6月30日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(六)募集资金使用的其他情况  
公司于2020年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将募集资金投资项目之一“高端晶圆处理产业化项目”实施地点由“沈阳市浑南区新街80号”变更为“沈阳市浑南区东关大街一街,南至规划地线,西至沈太大街,北至顺一路”。上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式,不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响。

公司于2021年3月19日召开了第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期》的议案》,同意公司将“高端晶圆处理产业化项目”的达到预定可使用状态时间调整至2023年6月31日,将“高端晶圆处理产业化项目”的达到预定可使用状态时间调整至2023年6月31日,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。本次募集资金投资项目延期系公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,不涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的事项,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况  
截至2021年6月30日,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会  
2021年8月28日

附表1: 募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额        | 50,574.41 | 本年度投入募集资金总额 | 7,615.20  |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 变更用途的募集资金总额   | 不适用       | 已计入募集资金总额   | 10,401.94 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用       | 已计入募集资金总额   | 10,401.94 |

| 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金总额(万元) | 调整后募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 本年度投入募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期(年-月) | 本报告期投入募集资金总额(万元) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) |
|----------------|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 是              | 50,574.41  | 50,574.41     | 50,574.41        | 7,615.20        | 7,615.20         | 2022年6月31日         | 7,615.20         | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     |

| 募集资金投资项目(含募集资金投资项目) | 募集资金总额(万元) | 调整后募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 本年度投入募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期(年-月) | 本报告期投入募集资金总额(万元) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 高端晶圆处理产业化项目         | 50,574.41  | 50,574.41     | 50,574.41        | 7,615.20        | 7,615.20         | 2022年6月31日         | 7,615.20         | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     |

| 募集资金投资项目(含募集资金投资项目) | 募集资金总额(万元) | 调整后募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 本年度投入募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期(年-月) | 本报告期投入募集资金总额(万元) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 高端晶圆处理产业化项目         | 50,574.41  | 50,574.41     | 50,574.41        | 7,615.20        | 7,615.20         | 2022年6月31日         | 7,615.20         | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     |

| 募集资金投资项目(含募集资金投资项目) | 募集资金总额(万元) | 调整后募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 本年度投入募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期(年-月) | 本报告期投入募集资金总额(万元) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 高端晶圆处理产业化项目         | 50,574.41  | 50,574.41     | 50,574.41        | 7,615.20        | 7,615.20         | 2022年6月31日         | 7,615.20         | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     |

| 募集资金投资项目(含募集资金投资项目) | 募集资金总额(万元) | 调整后募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 本年度投入募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期(年-月) | 本报告期投入募集资金总额(万元) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 高端晶圆处理产业化项目         | 50,574.41  | 50,574.41     | 50,574.41        | 7,615.20        | 7,615.20         | 2022年6月31日         | 7,615.20         | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     |

| 募集资金投资项目(含募集资金投资项目) | 募集资金总额(万元) | 调整后募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 本年度投入募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期(年-月) | 本报告期投入募集资金总额(万元) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 高端晶圆处理产业化项目         | 50,574.41  | 50,574.41     | 50,574.41        | 7,615.20        | 7,615.20         | 2022年6月31日         | 7,615.20         | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     |

| 募集资金投资项目(含募集资金投资项目) | 募集资金总额(万元) | 调整后募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 本年度投入募集资金总额(万元) | 截至报告期末募集资金总额(万元) | 项目达到预定可使用状态日期(年-月) | 本报告期投入募集资金总额(万元) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) | 本报告期投入募集资金总额占募集资金总额的比例(%) |
|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 高端晶圆处理产业化项目         | 50,574.41  | 50,574.41     | 50,574.41        | 7,615.20        | 7,615.20         | 2022年6月31日         | 7,615.20         | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     | 15.05                     |

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 募集资金投资项目实施方式变更情况                                                                                       | 不适用 |
| 公司于2020年4月24日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,702.06万元置换预先投入自筹资金。 |     |